



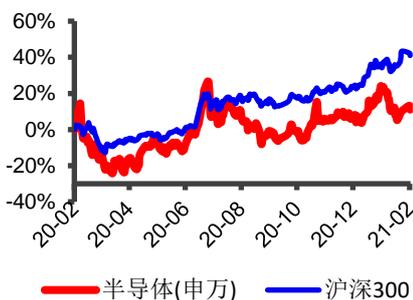
半导体与面板景气度持续

行业评级：增 持

本周焦点

报告日期：2021-03-21

行业指数与沪深300 走势比较



行情回顾

上周 SW 电子指数(-3.29%)整体表现弱于沪深 300 指数(-2.71%)，其中表现较好的为电子化学品板块。从细分板块来看，消费电子加权平均涨跌幅为-5.90%，跑输沪深 300 指数 3.19 个百分点；被动元件加权平均涨跌幅为-0.02%，跑赢沪深 300 指数 2.69 个百分点；显示面板加权平均涨跌幅为 1.55%，跑赢沪深 300 指数 4.26 个百分点；LED 板块加权平均涨跌幅为-6.21%，跑输沪深 300 指数 3.50 个百分点；安防板块加权平均涨跌幅为-3.30%，跑输沪深 300 指数 0.59 个百分点；电子化学品加权平均涨跌幅为 2.21%，跑赢沪深 300 指数 4.92 个百分点。

分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

研究助理：华晋书

执业证书号：S0010119040018

邮箱：huajs@hazq.com

半导体产能愈发紧张

2月13日日本东北部7.3地震和地震后停电，导致瑞萨、村田、信越化学等位于该地区的工厂出现停滞，现在已部分恢复运行，争取尽快达到正常运行状态。该事件可能加剧汽车半导体与全球半导体材料、被动元器件短缺。

2月18日美国德州大部分地区出现暴雪天气，导致三星、恩智浦、德州仪器等半导体公司部分工厂产能出现停滞，这可能加剧芯片供应短缺。

目前晶圆代工产能持续吃紧，从需求方面看，手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、共享电单车、新能源车 PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了半导体持续繁荣，供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

且自2020年12月下旬，以MOSFET, MCU为代表的龙头公司陆续开始涨价10-20%甚至更多。目前芯片大厂排队加价大抢产能，国内外的8寸和12寸晶圆产能持续紧张，晶圆厂2020年Q4报价已全面看涨，并掀起一波涨价效应，同时半导体硅晶圆片厂也在布局涨价。我们认为IDM和代工、以及半导体材料板块2021年上半年业绩确定性高，且景气度有望持续全年。

相关报告

- 《华安证券_行业研究_大国雄芯.半导体行业系列报告(一):科技创“芯”,时代最强音》2020-05-13
- 《华安证券_行业研究_大国雄芯.半导体行业系列报告(二):手机CIS逆势增长景气延续》2020-05-14
- 瑞芯微(603893.SH)《大国雄芯.半导体行业系列报告(三):专注SOC设计,发力电源管理领域》2020-06-03
- 《华安证券_行业研究_大国雄芯.半导体行业系列报告(四):小间距LED持续景气,MiniLED蓄势待发》2020-07-01

面板周期上行+格局改善,龙头确定性强

根据市调机构WitsView 2021年3月5日统计的面板3月上旬报价,相比2月下旬:65寸均价提高5美元,55寸提高5美元,43寸提高2美元,32寸提高2美元,面板价格维持较高的四季度面板厂各技术别也基本处于高稼动运转状态,我们认为四季度和明年上半年面板都将保持较高景

气度，国内面板龙头公司受益于行业上行周期和竞争格局改善的双重逻辑，持续看好面板龙头公司明年的业绩表现。

推荐关注：斯达半导、新洁能、华润微、韦尔股份、思瑞浦、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、敏芯股份、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL 科技。

风险提示

- 1) 政策落实对半导体产业的推动效果尚不明确；
- 2) 宏观经济下行，面板下游需求不及预期。

正文目录

1 本周行业观点:	5
1.1 面板周期上行+格局改善, 龙头确定性强	5
1.2 8 寸晶圆紧张扩散, 半导体上行周期持续	6
2 市场行情回顾	8
2.1 本周板块指数涨跌幅	8
2.2 本周电子个股表现	10
2.3 行业数据变化	12
3 个股重点新闻	17
风险提示:	25

图表目录

图表 1 中大尺寸 LCD 显示面板价格走势 (美元)	5
图表 2 韩厂大尺寸 LCD 面板退出情况	6
图表 3 全球功率半导体市场规模	7
图表 4 华润微 MOSFET 营收本土厂商第一, 市占率 8.7%	7
图表 5 IGBT 三大产品形式的竞争格局	8
图表 6 本周板块指数行情统计	9
图表 7 本周各行业涨跌幅统计 (单位: %)	9
图表 8 本周电子行业各板块涨跌幅 (单位: %)	10
图表 9 本周电子行业个股涨跌幅前十	10
图表 10 本周电子行业涨幅前十名柱状图 (单位: %)	11
图表 11 本周电子行业跌幅前十名柱状图 (单位: %)	11
图表 12 北美半导体设备制造商: 出货额: 当月值 (单位: 百万美元)	12
图表 13 日本: 半导体制造设备: 出货额: 当月值 (单位: 百万日元)	12
图表 14 全球硅片季度出货量 (单位: 百万平方英寸)	13
图表 15 液晶电视 32 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	13
图表 16 液晶电视 43 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	14
图表 17 液晶电视 55 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	14
图表 18 液晶电视 65 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	15
图表 19 笔记本电脑 15.6 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	15
图表 20 平板电脑 10.1 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	16
图表 21 手机面板 6.22 英寸周度平均价格 (单位: 美元)	16

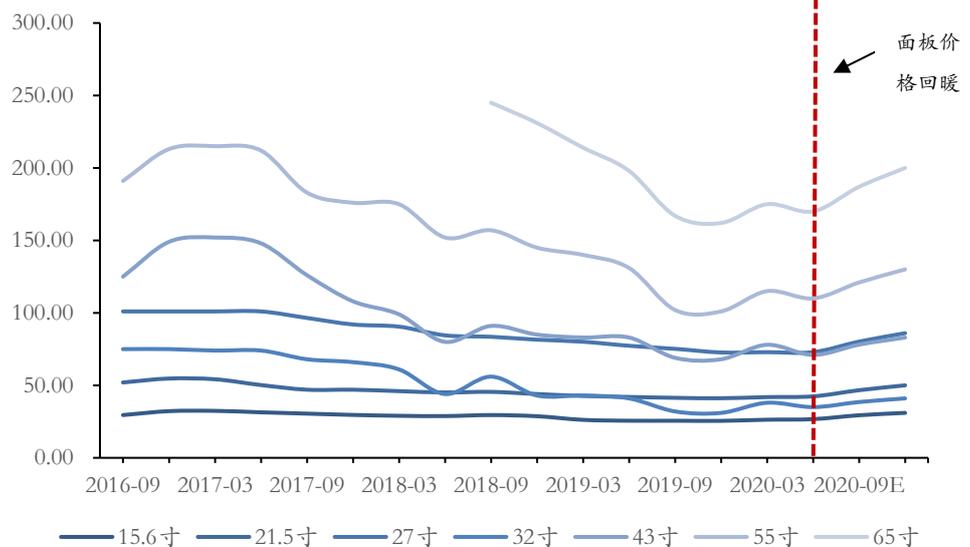
1 本周行业观点：

1.1 面板周期上行+格局改善，龙头确定性强

3月上旬面板仍然呈现上涨态势，面板缺货明显。据台湾中央社，大陆电子业重要大本营深圳出现面板代理商大规模破天荒暂停报价、停止接单潮，凸显这一波面板缺货状况严重，卖方市场确立，面板自下半年涨价以来，7至2月上旬报价一路扬升，市场认为面板价格明年上半年仍是上涨的态势，有助面板厂Q1营运。

2020Q4以来各尺寸面板全面景气。根据 TrendForce 显示器研究处表示，受惠于北美电视需求大幅上升两成，以及上半年电视品牌厂因疫情将出货时程递延，使第三季旺季效应更加显著，出货量以 6,205 万台创下单季历史新高纪录，季增幅高达 38.8%，年增 12.9%。展望 2021Q1，面板价格仍将持续上涨，若市场需求热度不减，预期品牌仍将积极以达成年度出货为目标，同时扩大市占率，预估出货量将达季成长 4%，上看 6,453 万台。宅经济下电视平板和笔电需求持续旺盛，面板产业在去年三季度后进入上行周期，各尺寸全面景气。

图表 1 中大尺寸 LCD 显示面板价格走势（美元）



资料来源：TrendForce，WitsView 睿智显示调研，华安证券研究所

大尺寸 LCD 竞争格局加速重构，“双子星”格局继续巩固。大尺寸 LCD 的产能从韩国和台湾地区转到中国大陆后，行业竞争格局发生了明显的改变，逐渐形成了 TCL 和京东方两家企业领跑市场的“双子星”格局。随着 TCL 收购三星苏州生产线，京东方收购中电熊猫生产线，叠加韩国企业 2021 年全面退出的因素，TCL 华星和京东方的市场份额将会超过 50%， “双子星”格局继续巩固。

图表 2 韩厂大尺寸 LCD 面板退出情况

厂商	工厂名称	世代线	市场	产能分布 (K/月)						产线情况
				Q3'19	Q4'19	Q1'20	Q2'20	Q3'20	Q4'20	
LG Display	广州 (GP1)	8.5	TV	110	110	110	110	110	110	中国工厂产能不退出
	广州 (GP2)	8.5	TV	100	100	100	100	100	100	
	LGD Paju P8	8.5	TV	205	170	100	100	100	100	2020 年实际产能减半
	LGD Paju P9 G8	8.5	APPLE	40	40	40	40	40	40	苹果的供货产能不减
	LGD Paju P9 G8	8.5	APPLE	50	50	50	50	50	50	
	LGD Paju P7	7	it&TV	220	220	140	105	50	0	预计 2020 年底产能全部退出
Samsung Display	SD Suzhou	8.5	TV	125	125	125	125	100	0	产线转让, 实际产能不减
	SEC Tangjiong L7-2	7	it&TV	165	165	165	165	100	0	预计 2020 年底产能全部退出
	SEC Tangjiong L8-1	8.5	it&TV	110	105	105	105	55	0	预计 2020 年底产能全部退出
	SEC Tangjiong L8-2	8.5	it&TV	150	127	127	80	50	0	预计 2020 年底产能全部退出

资料来源: 华安证券研究所整理

我们认为本轮价格的上升周期将持续一至两年。不考虑疫情因素, 行业需求每年持续增长, 小年增长 3%-5%、大年增长 6%-8%。另一方面, 行业供给首次出现负增长, 三星、LG 等海外公司已退出 20% 的供给, 大于国内新增 15% 的投入量。2020 年三季度和四季度供需呈现一个剪刀差, 需求往上, 供给往下。我们对 2021 年是产业复苏大年整体预期乐观。综合判断当前股价未充分反映基本面, 持续推荐国产面板巨头的投资机会。

1.2 北美雪灾日本地震半导体产能愈发紧张

2 月 13 日日本东北部 7.3 地震和地震后停电, 导致瑞萨、村田、信越化学等位于该地区的工厂出现停滞, 现在已部分恢复运行, 争取尽快达到正常运行状态。该事件可能加剧汽车半导体与全球半导体材料、被动元器件短缺。

2 月 18 日美国德州大部分地区出现暴雪天气, 导致三星、恩智浦、德州仪器等半导体公司部分工厂产能出现停滞, 这可能加剧芯片供应短缺。

晶圆代工两大龙头公司在近期披露的关于 2020 年第三季度的财报信息中皆表示营收已超过原先预期, 叠加近期 8 寸晶圆产能吃紧, 整个晶圆代工行业景气度逐渐进入上行周期, 主要是 5G 手机、NB 等促进 PMIC、Driver IC 需求, **同时半导体持续高景气也加剧了产能紧张。**

由于上游 8 寸晶圆代工产能偏紧, 致使显示驱动 IC 供货缺口在 20% 左右, 预计到 2021 年中才会有所缓解。目前 wafer 涨价都在 10% 以上, 而显示驱动 IC 涨价根据不同厂商吸收成本的能力而定。Omdia 称, 从第三季度开始, TV 面板的需求开始反弹, 大尺寸显示驱动芯片需求随之增长, 但是全球 8 寸晶圆产能没有增加, 而 PMIC 等产品也在增长并能获得更好的营业额和利润。在这种情况下, 晶圆厂更愿意分配更多的产能给那些利润更好的产品, 显示驱动芯片的晶圆供应短缺状况更加严重。TrendForce 表示, 在面板需求强劲的情况下, 2020 下半年起显示驱动 IC 供给开始出现吃紧。因晶圆代工产能供应紧张, 使得代工费用上涨, IC 厂商对面板厂的显示驱动 IC 报价从第

三季度起正式涨价，不排除将延续至第四季的可能。

台积电、联电、世界先进、力积电等第四季订单全满，先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空，凸显晶圆代工产能供不应求。缺货潮已经蔓延到国外 MCU。业内人士反映，国际 MCU 大厂的产品已经全线延期，新排单基本都不接。在国外 MCU 持续缺货的背景下，许多终端制造厂纷纷选择使用国产 MCU 替代，也给国产 MCU 厂商带来了一定机遇。

图表 3 全球功率半导体市场规模



资料来源：IHS Market，华安证券研究所

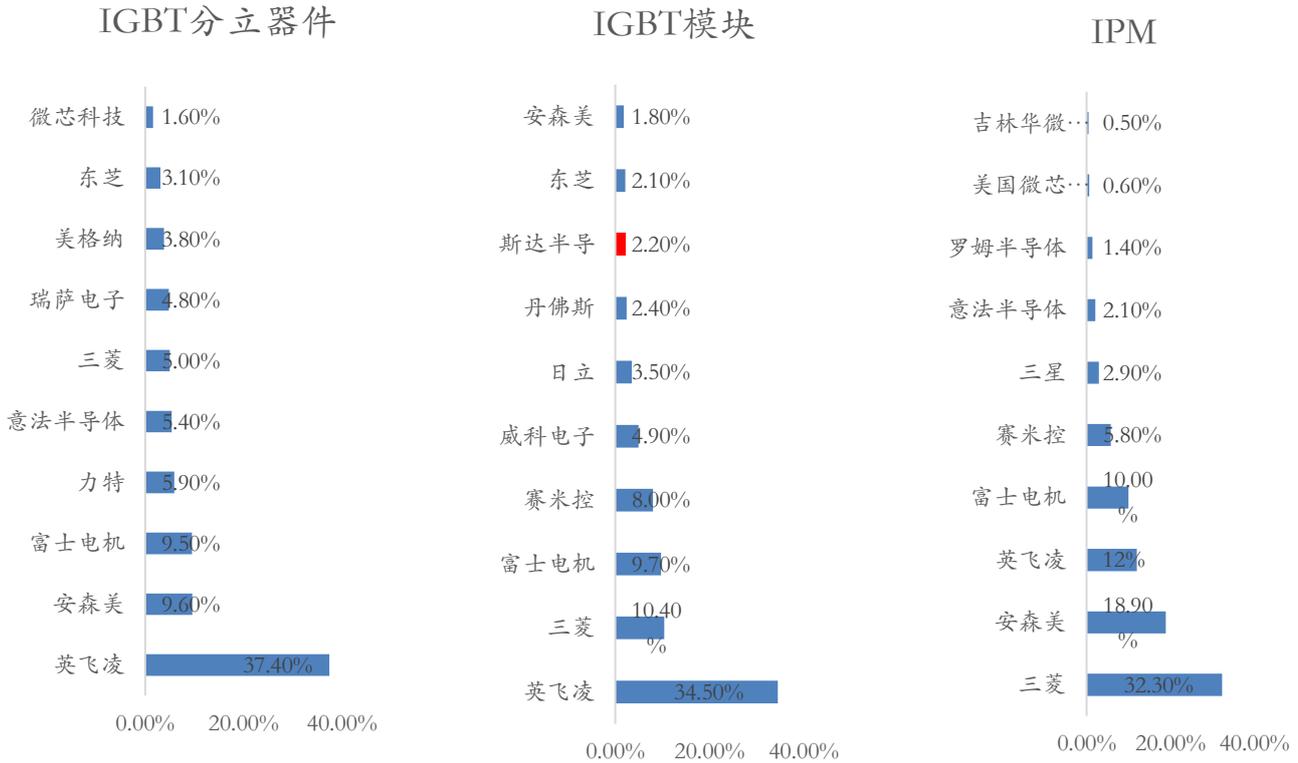
具体到功率半导体，从需求方面看，手机快充、Type-C 接口等消费电子、两轮电动车、共享单车、新能源车 PHEV/EV、光伏风电、工控替代等下游领域快速发展，促进了以 MOSFET 和 IGBT 为代表的功率半导体持续繁荣；从供给端来看，今年一波三折的疫情对海外的功率厂商产能和物流带来了诸多的限制，国内疫情率先控制，对国内领先的功率半导体厂商来说，供给端竞争格局得到优化，国产替代进程加速。

目前国内厂商在 IGBT 和 MOSFET 领域的市占率还很低：

图表 4 华润微 MOSFET 营收本土厂商第一，市占率 8.7%

排名	企业名称	2018 年 MOSFET 器件销售额 (亿元)	市场份额占比
1	英飞凌	52	28.40%
2	安森美	31	16.90%
3	华润微	16	8.70%
4	瑞萨电子	12	6.60%
5	东芝	12	6.60%
6	意法半导体	9	4.90%
7	其他企业	51	27.90%
	合计	183	100%

资料来源：华润微招股说明书，IHS，华安证券研究所

图表 5 IGBT 三大产品形式的竞争格局


数据来源：IHS Markit，英飞凌，华安证券研究所

推荐关注：斯达半导、新洁能、华润微、韦尔股份、思瑞浦、紫光国微、中芯国际、瑞芯微、敏芯股份、北方华创、中微公司、闻泰科技、汇顶科技、卓胜微、兆易创新、圣邦股份、柏楚电子、TCL 科技。

2 市场行情回顾

2.1 本周板块指数涨跌幅

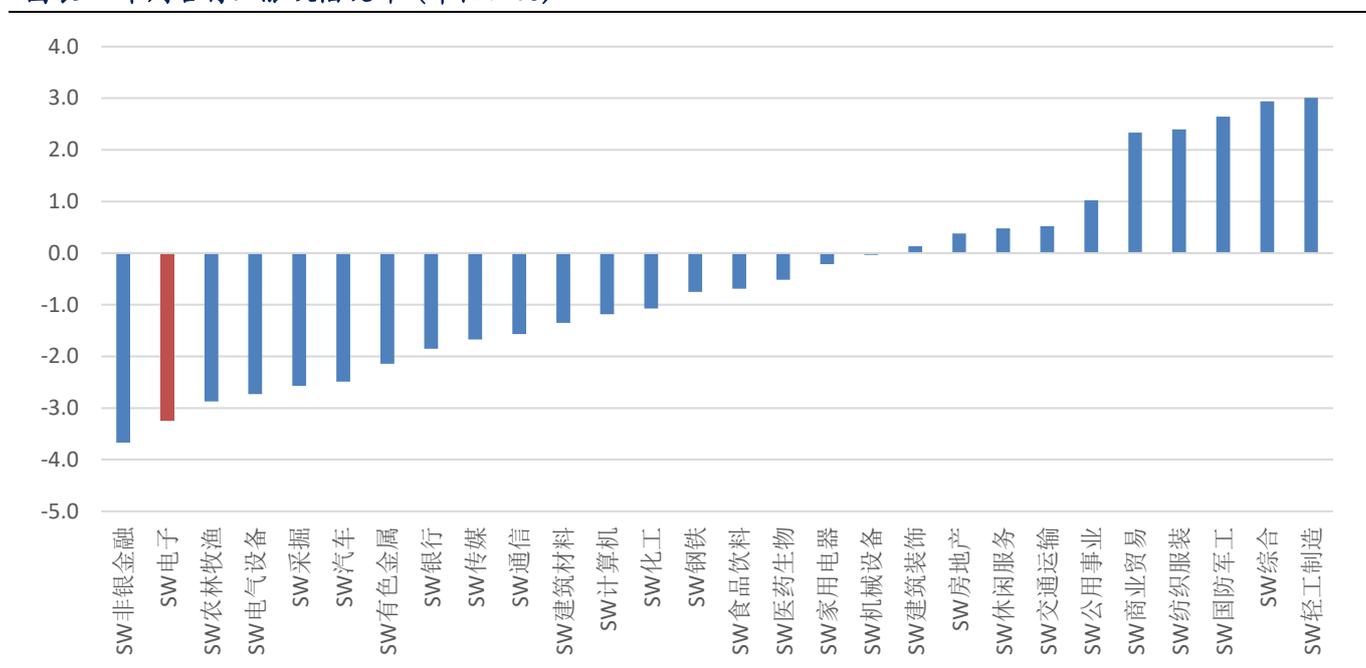
上周 SW 电子指数(-3.29%)整体表现弱于沪深 300 指数(-2.71%)，其中表现较好的为电子化学品板块。从细分子板块来看，消费电子加权平均涨跌幅为-5.90%，跑输沪深 300 指数 3.19 个百分点；被动元件加权平均涨跌幅为-0.02%，跑赢沪深 300 指数 2.69 个百分点；显示面板加权平均涨跌幅为 1.55%，跑赢沪深 300 指数 4.26 个百分点；LED 板块加权平均涨跌幅为-6.21%，跑输沪深 300 指数 3.50 个百分点；安防板块加权平均涨跌幅为-3.30%，跑输沪深 300 指数 0.59 个百分点；电子化学品加权平均涨跌幅为 2.21%，跑赢沪深 300 指数 4.92 个百分点。

图表 6 本周板块指数行情统计

指数名称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
上证指数	-1.69%	-1.97%
深证成指	-2.09%	-5.98%
创业板指	-3.09%	-9.94%
沪深 300	-2.71%	-3.92%
电子(申万)	-3.29%	-9.35%
半导体指数	-4.81%	-11.08%

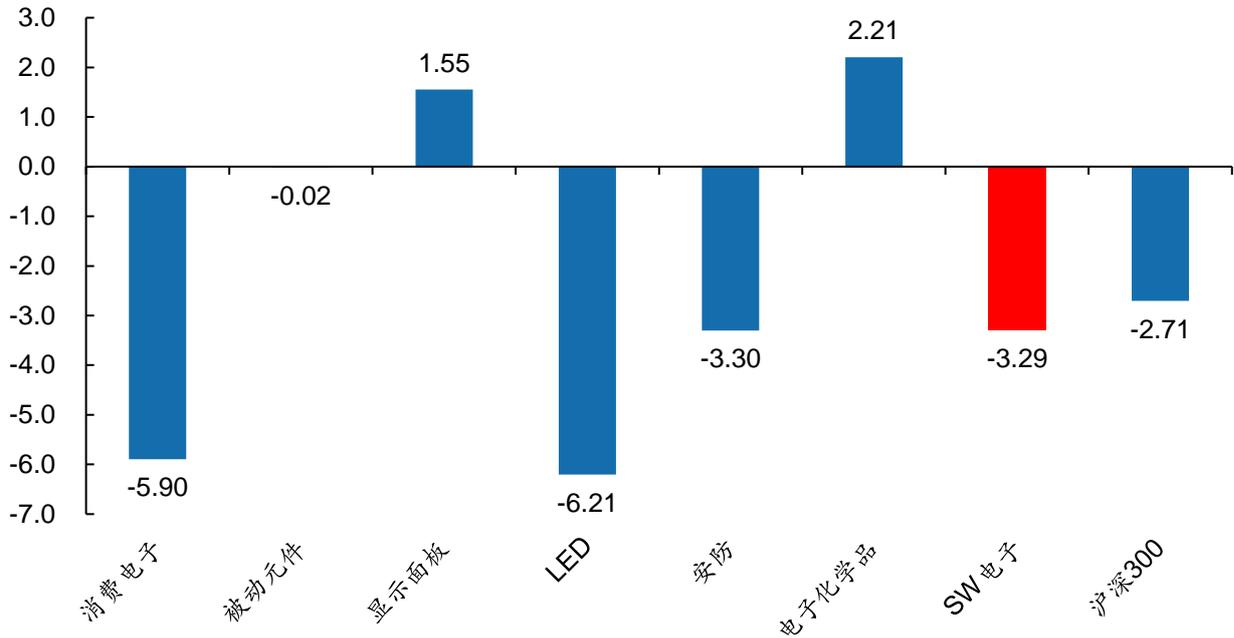
资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 7 本周各行业涨跌幅统计 (单位：%)



资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 8 本周电子行业各板块涨跌幅（单位：%）



资料来源：WIND，华安证券研究所

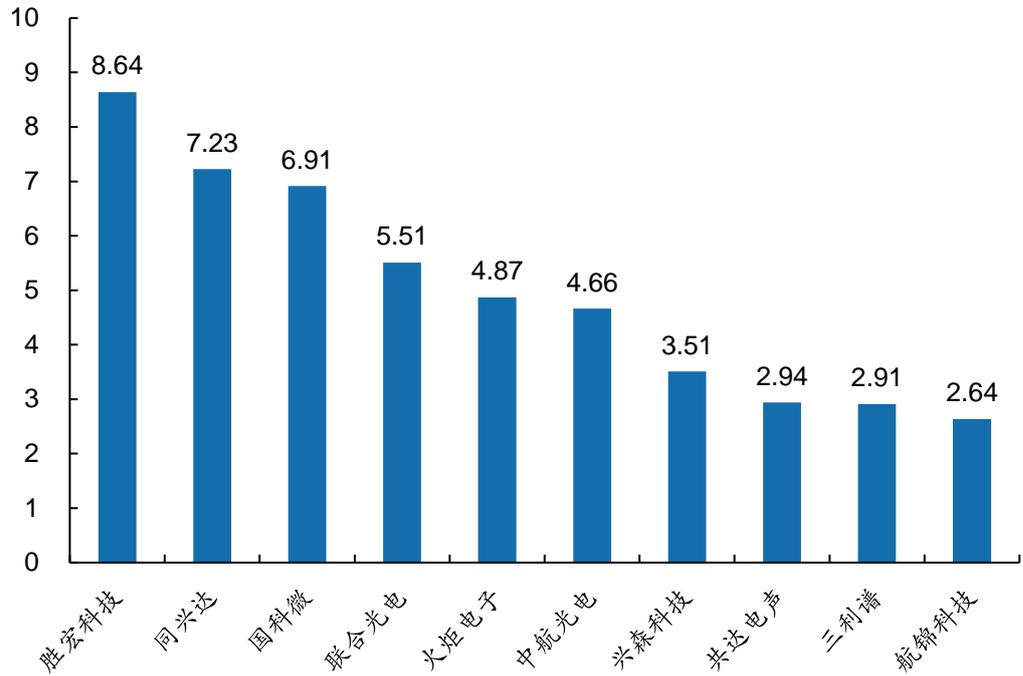
2.2 本周电子个股表现

图表 9 本周电子行业个股涨跌幅前十

周涨幅前十		周跌幅前十	
胜宏科技	8.64%	欧菲光	-18.26%
同兴达	7.23%	华灿光电	-16.36%
国科微	6.91%	深南电路	-14.95%
联合光电	5.51%	三安光电	-14.90%
火炬电子	4.87%	立讯精密	-12.26%
中航光电	4.66%	惠伦晶体	-11.46%
兴森科技	3.51%	鹏鼎控股	-10.58%
共达电声	2.94%	沪硅产业-U	-9.72%
三利谱	2.91%	领益智造	-9.49%
航锦科技	2.64%	生益科技	-9.44%

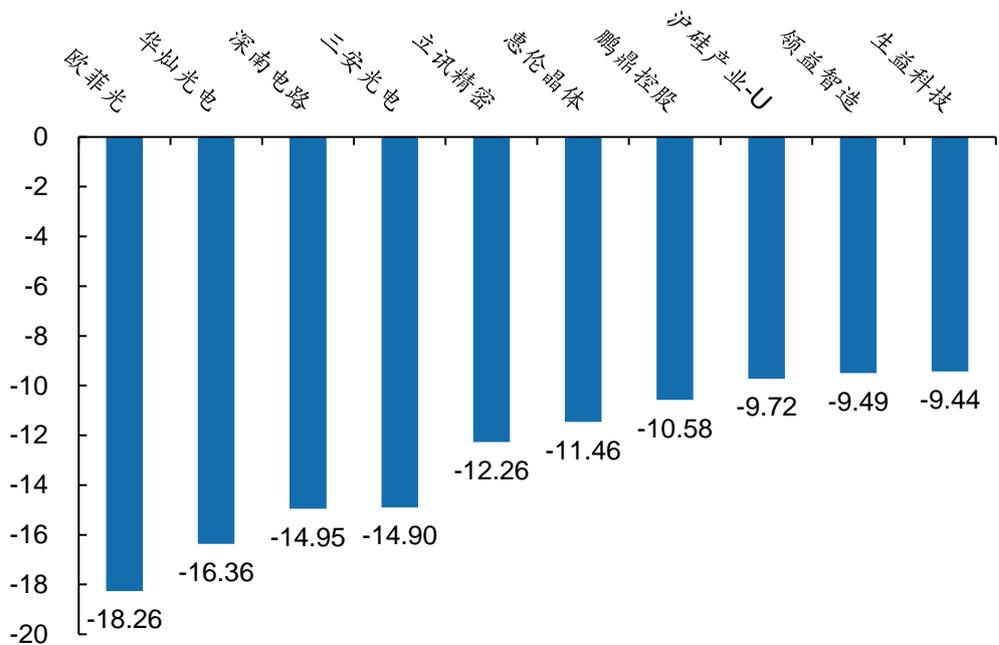
资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 10 本周电子行业涨幅前十名柱状图 (单位: %)



资料来源: WIND, 华安证券研究所

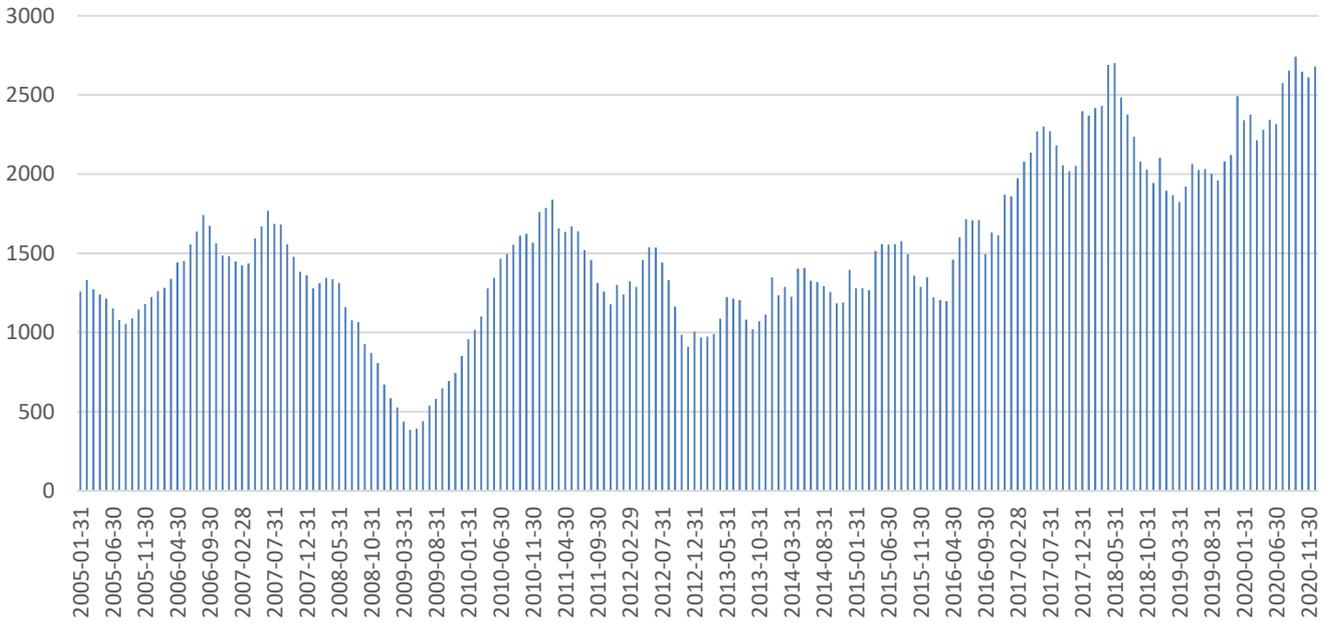
图表 11 本周电子行业跌幅前十名柱状图 (单位: %)



资料来源: WIND, 华安证券研究所

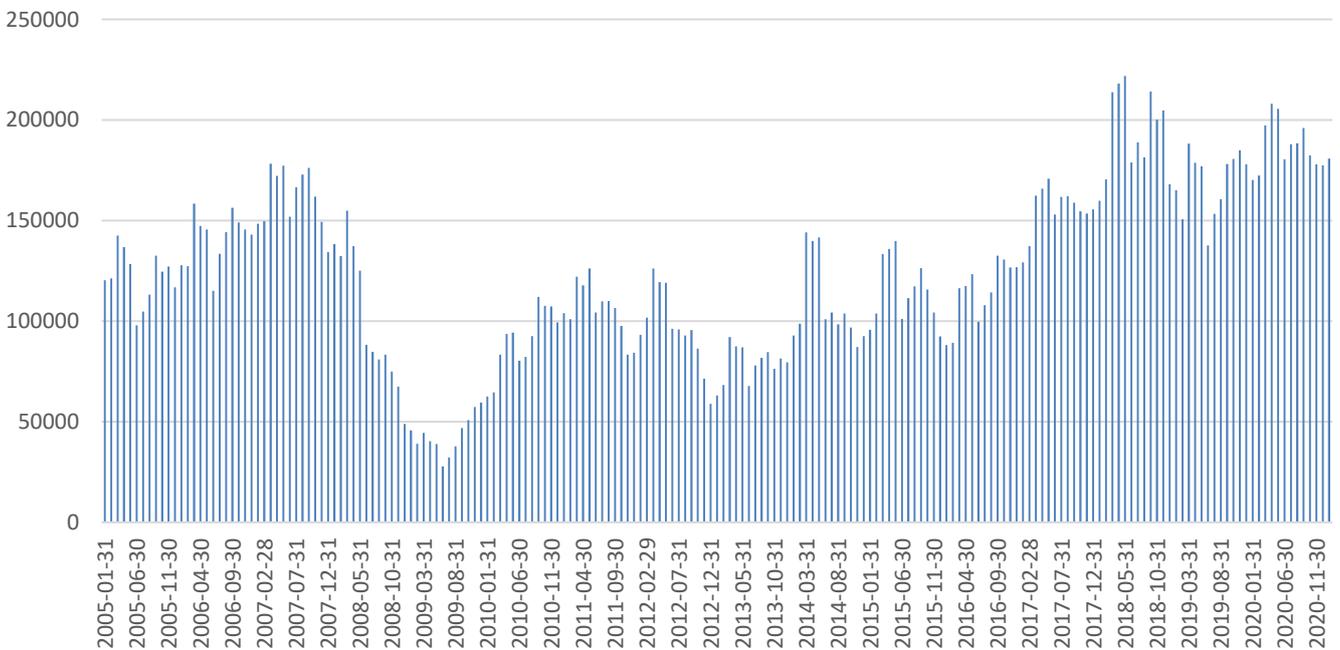
2.3 行业数据变化

图表 12 北美半导体设备制造商:出货额:当月值 (单位: 百万美元)

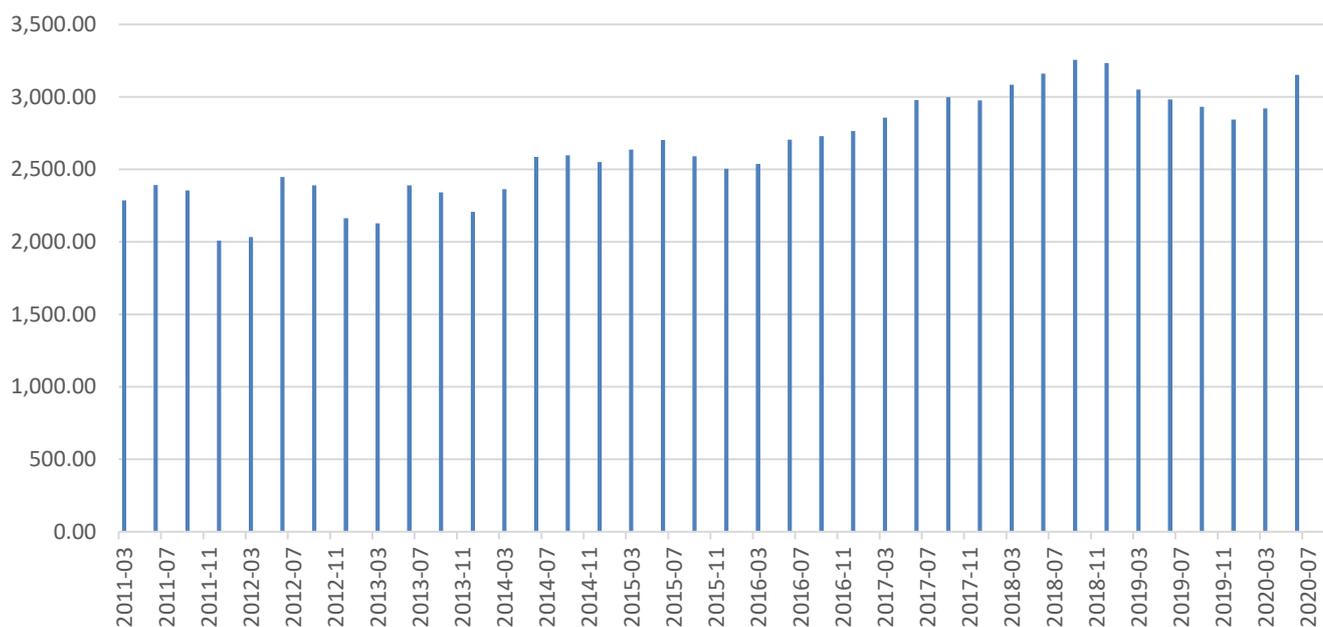


资料来源: wind, 华安证券研究所

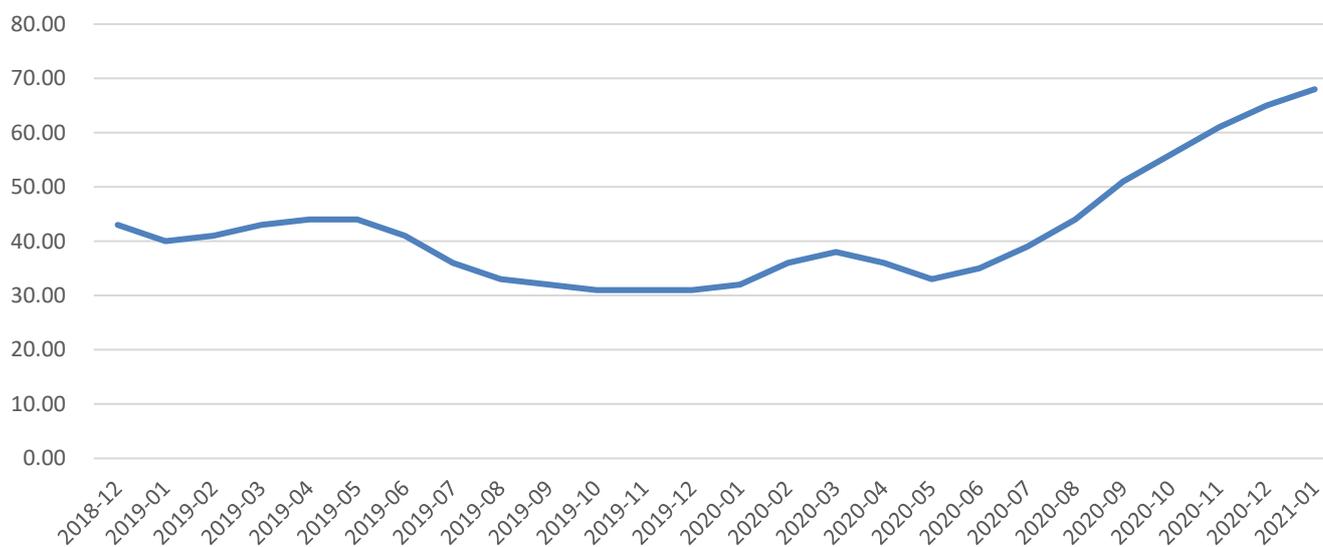
图表 13 日本:半导体制造设备:出货额:当月值 (单位: 百万日元)



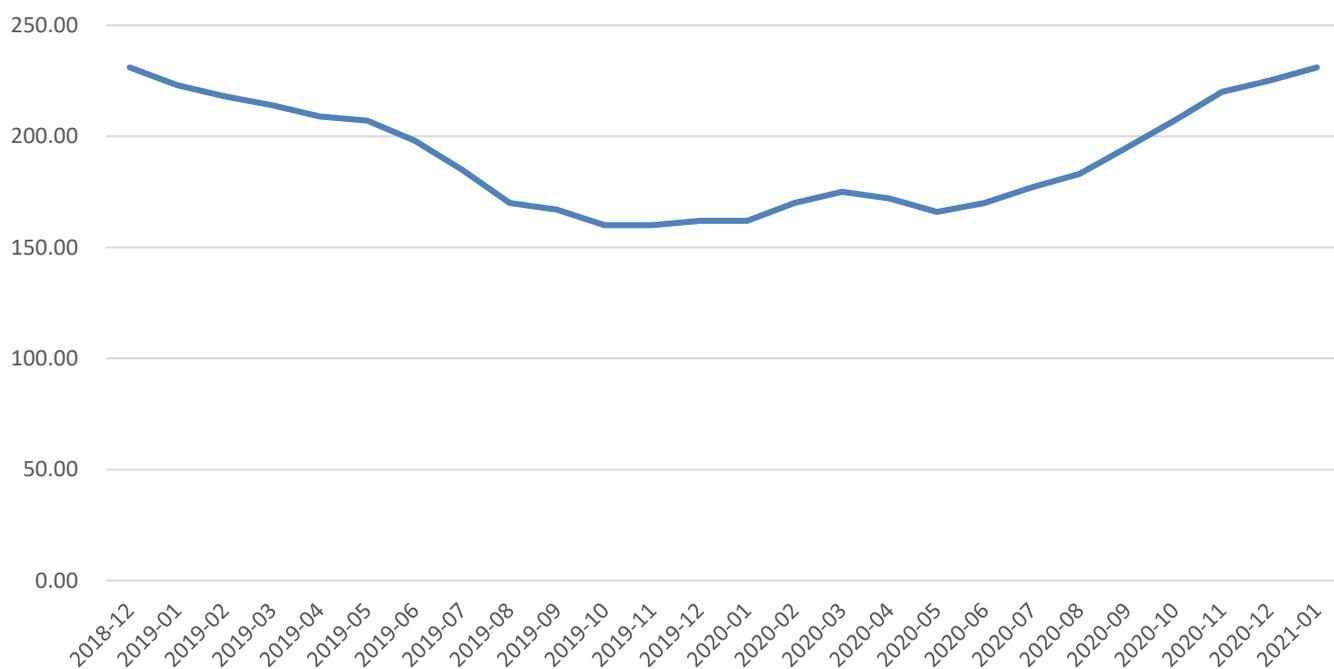
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 14 全球硅片季度出货量 (单位: 百万平方英寸)


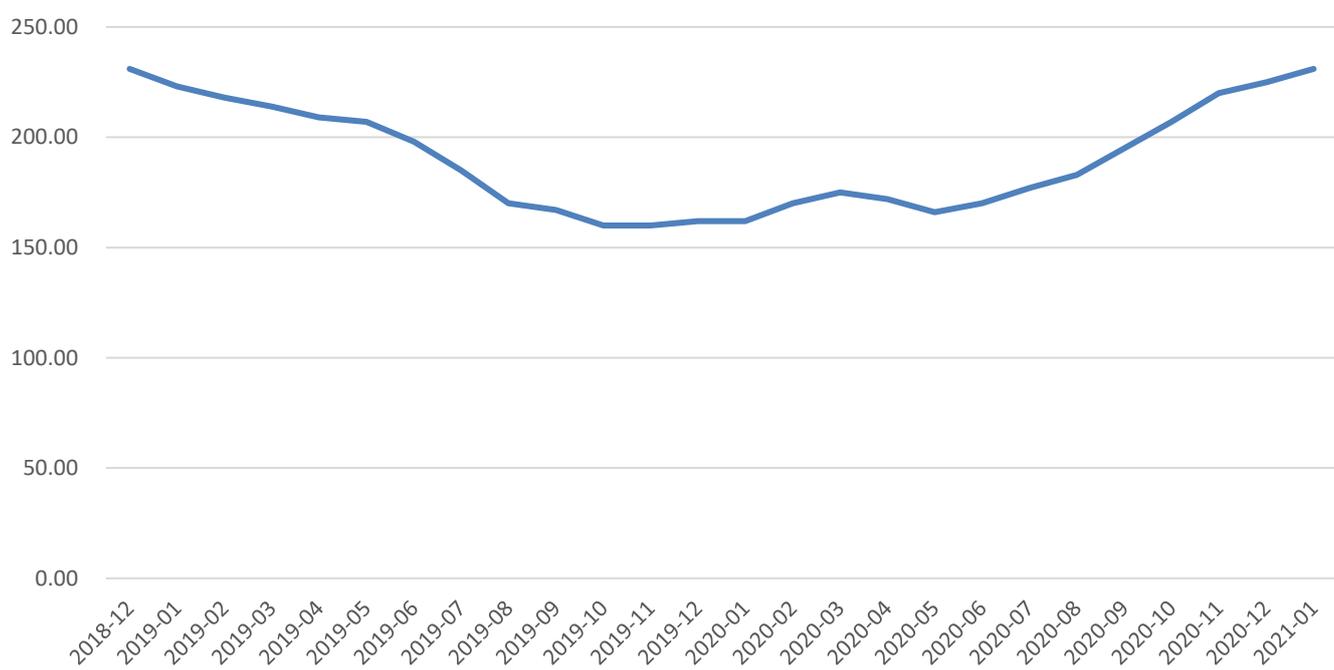
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 15 液晶电视 32 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


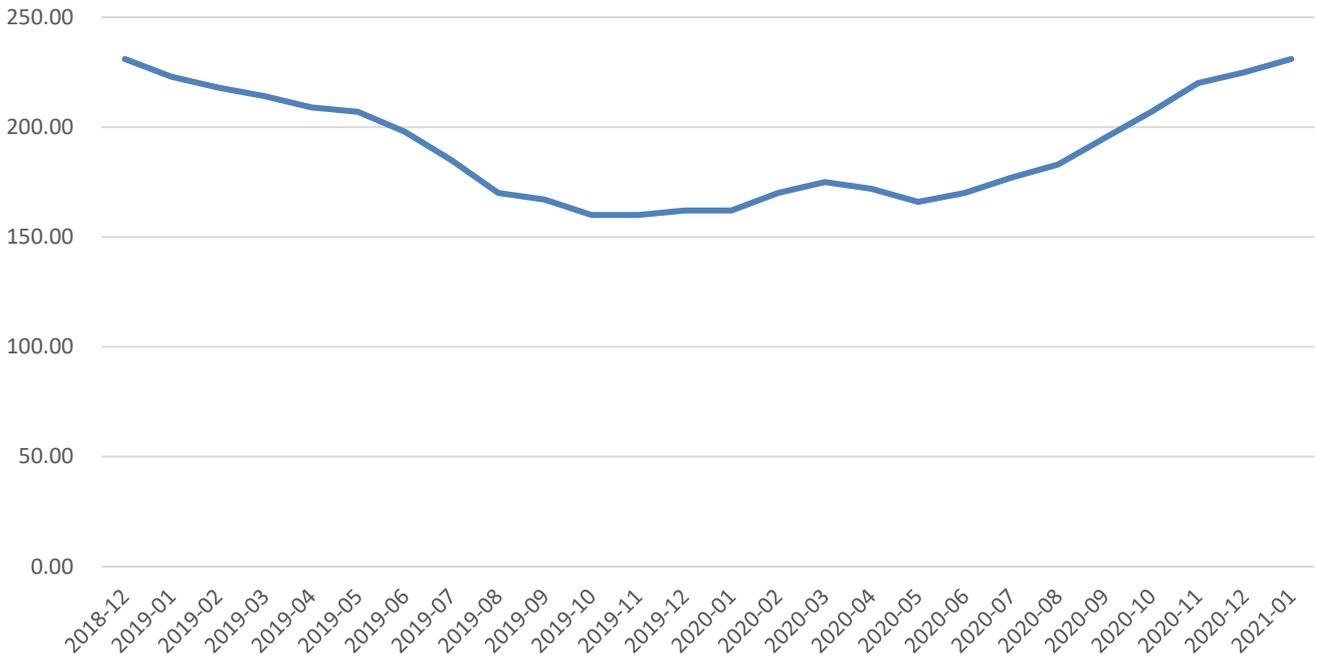
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 16 液晶电视 43 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


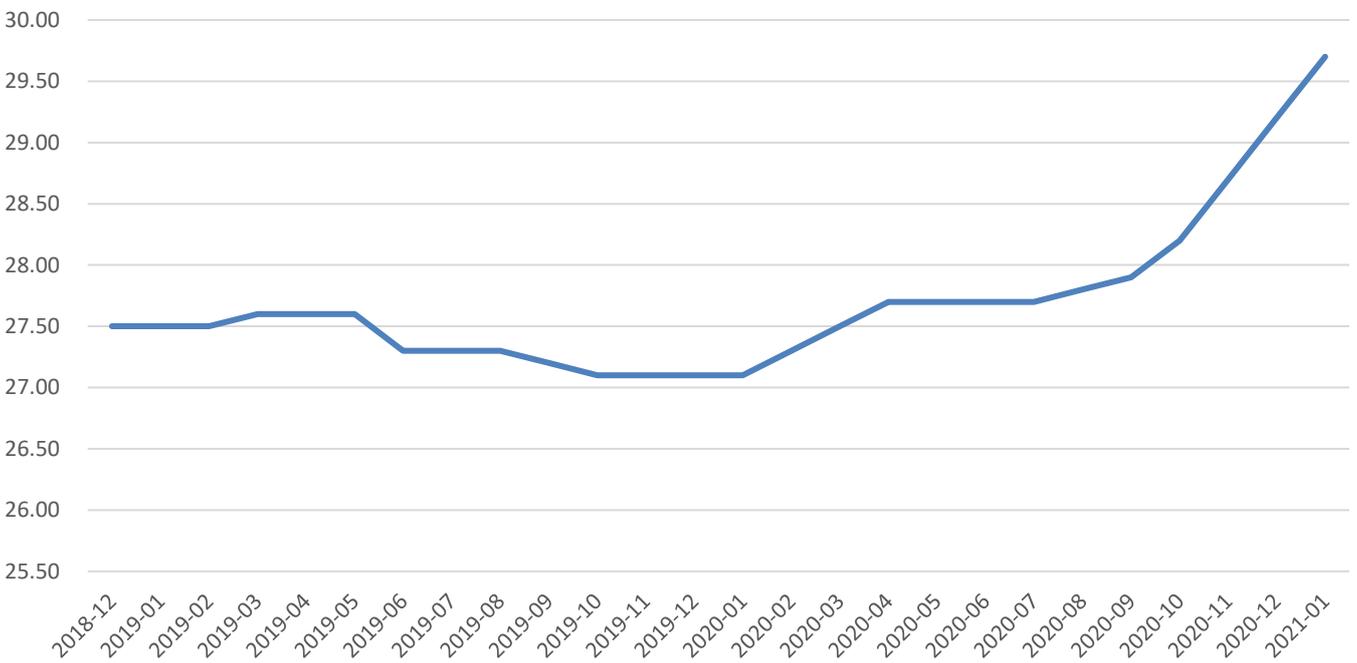
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 17 液晶电视 55 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


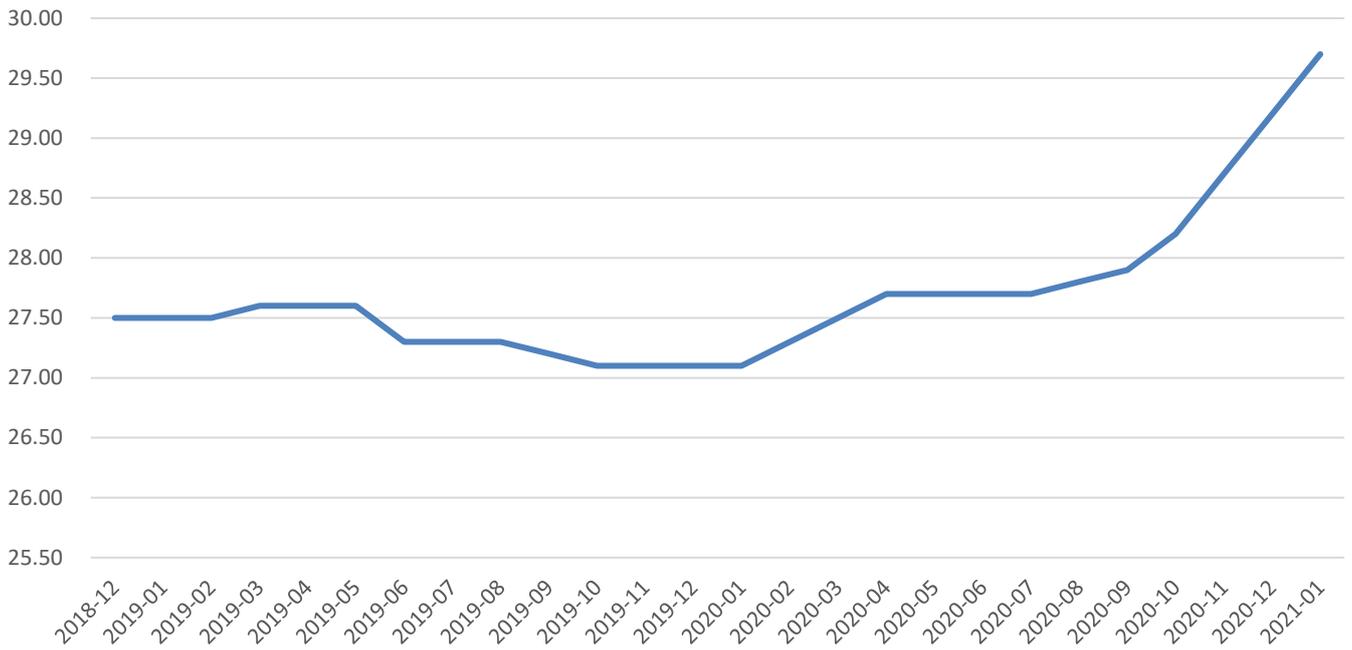
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 18 液晶电视 65 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


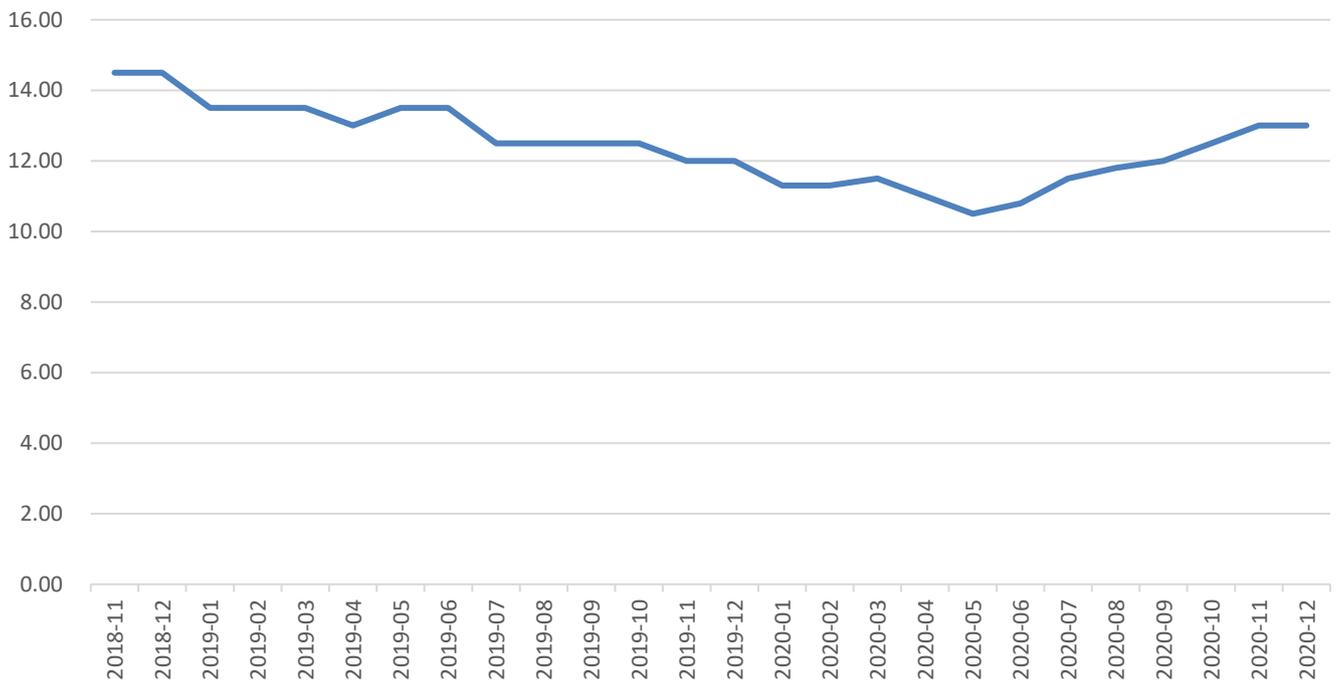
资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 19 笔记本电脑 15.6 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 20 平板电脑 10.1 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


资料来源: wind, 华安证券研究所

图表 21 手机面板 6.22 英寸周度平均价格 (单位: 美元)


资料来源: wind, 华安证券研究所

3 个股重点新闻

【高通】高通完成对 NUVIA 的收购

2021 年 3 月 16 日，圣迭戈——高通公司 (NASDAQ: QCOM) 宣布，其子公司高通技术公司以 14 亿美元（运营资本和其它调整前）完成对世界级 CPU 和技术设计公司 NUVIA 的收购。高通技术公司计划在广泛的产品组合中集成下一代 CPU，赋能旗舰智能手机、笔记本电脑、数字座舱与先进驾驶辅助系统、扩展现实以及基础设施网络解决方案。首批采用高通技术公司内部设计的全新 CPU 的高通骁龙平台预计将于 2022 年下半年出样，旨在支持高性能超便携笔记本电脑。（旭日大数据）

【长电科技】汽车产业缺芯潮，先进封装迎机遇

在本届 SEMICONChina2021 主论坛上，长电科技首席执行官兼董事郑力表示这一次的汽车产业‘缺芯’潮，意味着车产业和芯片产业已经形成了前所未有的紧密关系。在数字化进程加速之际，具备更高封装效率、更低设计成本和更出色性能等特点的先进封装，已成为集成电路产业发展的新引擎之一，也是如今汽车产业发展的关键之道。郑力认为，汽车产业超过九成的创新是基于芯片，而先进的集成电路封装技术，同时也是集成电路成品制造技术和产品解决方案，是芯片向高性能、高集成度和高可靠性方向发展越来越为重要的产业基础和技术趋势。随着后疫情时代的来临，车载芯片制造供应链开启了大规模重组模式，并引发了全新的机遇。郑力认为，这也是先进封装技术在汽车产业一展宏图的好时机。对于车载芯片成品制造而言，郑力认为，应当主要关注四大关键要素：技术、制程、质量和意识，从而能够有效致力于技术的创新并促进产研生态成长，推动行业发展。（半导体协会）

【高通】高通自曝首颗自研 CPU 内核骁龙芯片：2022 年出样、面向高性能便携本

3 月 16 日，高通公司宣布，首颗采用全新内部设计 CPU 的骁龙平台芯片将于 2022 年下半年出样，面向高性能便携式笔记本。当前用于笔记本平台的骁龙 CPU 是骁龙 8cx 第二代，CPU 为八个 Kryo 495，显然，Kryo 在高通眼里并非所谓全新内部设计。（新浪财经）

【苹果】苹果正自研 5G 基带，有望 2024 年使用，将由台积电代工

据台媒经济日报报道，在 iPhone 与 Mac 产品分别导入自行设计的 A 系列与 M 系列处理器后，苹果正在打造自家 5G 基带，最快 2024 年开始扩大设计采用。报道称，苹果在 2019 年收购英特尔基带团队后，相关研发投入有望逐步展现在手机基带设计领域。目前苹果基带晶片由高通提供，依据苹果先前和高通官司和解协议，双方已签订六年约采用高通基带晶片的合约，将于 2024 年中旬到期。美国 ITC 文件也显示，苹果和高通在基带晶片的合作至少会到 2024 年 5 月，主要品项‘X55’、‘X65’及‘X70’产品。报道称，苹果和高通双方合约期满后，苹果将开始使用自家 5G 基带，相关芯片也会由台积电代工生产。（台媒经济日报）

【日月光】日月光携 Deca 和西门子提升高阶封装制造能力

封测大厂日月光半导体与设备软件公司 Deca 以及西门子数字工业软件公司合作，推出自适应图案设计套件 (APDK) 方案，提升芯片异质整合高阶封装制造能力。日月光指出已在 APDK 取得成果，将全套自动化、设计规则、设计规则检查 (DRC) 平台和模板整合在一起，提供单一设计流程。日月光市场与技术推广高阶副总裁莱斯 (RichRice) 指出，日月光藉由提供可同时处理单一芯片及异质整合参数的解决方案，协助客户落实自动化设计，巩固扇出型 (Fan Out) 封装技术优势。（台媒经济日报）

【高通】高通芯片短缺，或影响三星中低端机型的生产

据路透社报道，高通很难跟上 Android 制造商所依赖的处理器芯片的需求。过去几个月的

需求激增。高通正面临其芯片中使用的一些子组件的短缺，组件问题可能会影响三星中低端机型的生产。高通旗舰产品骁龙 888 芯片受到影响。(数码之家)

【三星】三星全球首秀 3nm! 电压只需 0.23V

IEEE ISSCC 国际固态电路大会上，三星展示了 3nm 工艺制造的芯片，为 256Gb(32GB)容量的 SRAM 存储芯片。该工艺上第一次应用 GAAFET(环绕栅极场效应晶体管)技术，使用 MBCFET，容量 256Gb，面积 56 平方毫米，超低功耗，写入电流只需要 0.23V。3GAE 工艺相比于其 7LPP，可将晶体管密度增加最多 80%，性能提升最多 30%，或者功耗降低最多 50%。(快科技)

【新思科技】新思科技与芯耀辉在 IP 产品领域达成战略合作伙伴关系

新思科技与芯耀辉联合宣布，双方已达成数年期战略合作，新思科技授权芯耀辉运用新思科技 12-28 纳米工艺技术、适配国内芯片制造工艺的 DesignWare USB、DDR、MIPI、HDMI 和 PCI Express 的系列 IP 核。(公司官网)

【AMD】AMD 第三代 EPYC 处理器米兰重磅发布，超强性能再升级

AMD 正式发布了代号“Milan”(米兰)的第三代 EPYC(霄龙) 7003 系列处理器，将全新的 Zen3 架构带往服务器、数据中心。EPYC 7003 系列拥有最多 64 核心 128 线程、256MB 三级缓存，支持四/六/八通道 DDR4-3200 内存(单路最大 4TB)，支持 128 条 PCIe 4.0 通道。(快科技)

【高通】14 亿美元收购 NUVIA，高通强化芯片设计

高通宣布，其子公司高通技术公司以 14 亿美元完成对世界级 CPU 和技术设计公司 NUVIA 的收购。其后，高通技术计划在大批的产品组合中集成下一代 CPU，覆盖智能手机、笔记本电脑等电子产品。(快科技)

【英特尔】Intel 11 代酷睿桌面处理器上架：新 i5 1299 元起、价格普降

Intel 正式发布了第 11 代桌面酷睿处理器 (Rocket Lake)。其采用全新的 14nm Cypress CPU 架构，IPC(每时钟周期指令数)提升最多 19%。GPU 核显首次集成 Xe 架构，最多 48 个执行单元，对比上代性能提升最多达 50%，20 条 PCIe 4.0 通道 (独显+SSD 可直连 CPU) 等。经查，这批国行新品已经在京东上架。(快科技)

【美光】美光停止生产与英特尔联合开发的 3D XPoint 芯片并出售相关生产工厂

美光宣布他们将停止与英特尔 (Intel) 联合开发的一种内存芯片 3D XPoint 的生产，并将出售犹他州莱希 (Lehi) 的一家芯片厂。该公司官员对路透表示，该工厂将被出售，交易预计将在今年年底结束。(搜狐财经)

【澜起科技】董事长及总经理拟合计斥 2000 万至 4000 万元增持股份

澜起科技公布，公司董事长兼首席执行官杨崇和、董事兼总经理 Stephen Kuong-IoTai 拟于 2021 年 3 月 18 日起 6 个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持金额分别不低于人民币 1000 万元，分别不超过人民币 2000 万元；即两人合计增持金额不低于人民币 2000 万元，合计不超过人民币 4000 万元。(格隆汇)

【兆易创新】晶圆厂产能紧缺，扩产将受影响，自有 Dram 推出

兆易创新表示，目前公司与多个晶圆厂保持全面密切的合作关系。在当前晶圆产能非常紧张的情况下，公司和晶圆厂的紧密合作给公司带来稳定的能。2021 年公司获得的产能增量预估能在 30%以上，公司 DRAM 业务目前按计划进行中，2021 年上半年就会推出公司自有品牌的 Dram 产品。(wind)

【英特尔】正式发布 11 代 vPro 博锐商用平台：AI 性能领先友商 5 倍

Intel 正式面向中国市场推出第 11 代 vPro 商用平台，硬件上基于去年诞生的 Tiger Lake-U 系列低功耗平台，继承了 Tiger Lake 11 代酷睿的全新 Willow Cove CPU 架构、Iris Xe GPU 架构、AI 深度学习加速功能，以及新的媒体与显示引擎、Thunderbolt 4、PCIe 4.0、Wi-Fi 6。最突出的是 AI 性能，爆发一般提升了 8 倍。（快科技）

【晶盛机电】签订 20.79 亿元光伏设备订单

晶盛机电与中环协鑫及中环光伏签订共计 20.79 亿元的单晶炉及智能化加工设备销售合同。此次与光伏龙头企业签订设备购销合同，充分体现了公司晶体生长设备及智能化加工设备的市场竞争优势，进一步巩固了公司在光伏领域技术与规模双领先的龙头地位，公司产品的技术优势和先进性进一步强化，市场知名度进一步提升。（公司官网）

【闻泰科技】康旅集团拟转让 0.4% 股份予云南公投

闻泰科技收到公司股东云南省康旅控股集团有限公司（“康旅集团”）的《关于股份协议转让的告知函》，康旅集团与云南省工业投资控股集团有限责任公司（康旅集团的一致行动人，“云南工投”）于 2021 年 3 月 12 日签署了《股份转让协议》，约定康旅集团将所持公司无限售流通股 500 万股（占公司总股本约 0.40%）转让给云南工投。（格隆汇）

【英飞凌】650 V 快速水平转换 SOI EiceDRIVER™ 集成引导二极管提供卓越的坚固性和快速频率切换

德国慕尼黑-2021 年 3 月 17 日-英飞凌技术股份公司（FSE: IFX/QTCQX: IFNNY）扩大其 EiceDRIVER™ 产品组合，配备新的 650 V 半桥和高低侧门驱动程序，提供卓越的坚固性和快速频率切换。（公司官网）

【英飞凌】高效供电的车载电气系统采用西门子移动和英飞凌开发的技术

西门子移动和英飞凌联合开发了新的辅助转换器，以提高基于碳化硅（SiC）的功率半导体的车载电源系统的效率。通过 SiC 可以实现更高的切换速度和效率，以缩小变压器、电容器、冷却元件和外壳单元的尺寸。辅助转换器利用基于英飞凌 CoolSiC MOSFET 1200 V 技术的半桥拓扑中的功率半导体。根据设计，每个转换器将安装 8 到 16 个半桥模块。（公司官网）

【泰科天润】碳化硅写入十四五规划，快充市场成为第三代半导体突破口。

2021 年 3 月 13 日，新华网刊登了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，其中“集成电路”领域，特别提出碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体要取得发展。充电头网通过调研了解到，目前市面上可用于大功率 USB PD 快充电源领域的碳化硅有五家供应商，分别是 Alpha Power Solutions 创能动力、Global Power 泰科天润、Maplesemi 美浦森、SGKS 森国科以及 PY 平伟。（公司官网）

【安森美半导体】申明对气候变化行动和透明度的承诺

安森美半导体在其社会责任网页上发布了针对半导体行业的 2020 年可持续发展会计准则委员会（SASB）业绩。此外，该公司确认其可持续性计划与气候相关财务披露特别工作组（TCFD）的建议保持一致。结果加强了安森美半导体致力于解决全球气候变化的战略和计划的奉献精神。（公司官网）

【斯达半导】披露 2021 年股票期权激励计划草案

斯达半导(603290.SH)披露 2021 年股票期权激励计划草案，本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 67.00 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额 16,000 万股的 0.42%。本激励计划涉及的激励对象为 118 人，行权价格为每股 134.67 元。（格隆汇）

【意法半导体】隔离式栅极驱动器可以安全地控制碳化硅 MOSFET。

意法半导体的隔离式栅极驱动器 STGAP2SiCS 可以安全地控制碳化硅 MOSFET,并在高达 1200V 的高压电压下工作。STGAP2SiCS 能够产生高达 26V 的栅极驱动电压,其欠压锁定(UVLO)阈值提高了 15.5V,可以满足 SiC MOSFET 的导通要求。(公司官网)

【新洁能】独立董事辞职

新洁能 2021 年 3 月 19 日晚间发布公告称,黄益建因个人原因申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时一并辞去第三届董事会相关专门委员会的职务。(Wind)

【华灿光电】2024 年 MicroLED 芯片产值将达到 21 亿美元

华灿光电副总裁王江波于 SEMICON CHINA 中国显示大会上表示, Micro LED 是超高清显示的终极技术, Micro LED 显示将应用于电视、手机、AR/VR,车载显示、可穿戴电子、数字显示(商业广告与显示等),预估 2024 年在 TV 及 IT 显示器应用上, Micro LED 片量将有快速增长。2024 年在 TV 应用上, Micro LED 芯片产值将达到 21 亿美元。(格隆汇)

【华灿光电】全资子公司所获 2678 万元政府补助已到账

华灿光电全资子公司华灿光电(苏州)有限公司于 2020 年 12 月 25 日收到张家港经济技术开发区管理委员会《关于给予华灿光电(苏州)有限公司产业发展补贴的批复》的文件,同意拨付华灿光电(苏州)有限公司 2020 年产业发展补贴资金 2678 万元。该项补助资金 2678 万元已于 2021 年 03 月 16 日划拨至公司账户。(每日经济新闻)

【兆驰股份】控股股东 9476 万股质押续期

兆驰股份于近日收到公司控股股东南昌兆投关于 9476 万股股份质押续期事宜的通知。截至 3 月 18 日,上述股东及其一致行动人所持质押股份占公司总股本的 9.23%。(格隆汇)

【LG】LG Innotek 计划投资 5478 亿韩元

韩国 LG 集团的子公司 LG Innotek 计划投资 5478 亿韩元(约合人民币 32 亿元),以增加 iPhone 摄像头模块的产量。该公司将扩大其位于韩国的工厂,使用索尼和三星电子的图像传感器来构建模块。(日经亚洲评论)

【安克创新】拟 4.8 亿元新建全球化营销服务和品牌矩阵建设项目

安克创新(300866.SZ)公告,公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金 4.8 亿元(占超募资金总额的 40.84%),用于全球化营销服务和品牌矩阵建设项目的事项。(智通财经)

【小米】比亚迪和印度光弘科技将成为小米在印度的新供应商

小米集团印度地区高管称比亚迪和印度光弘科技将成为小米在印度的两家新的供应商(wind)

【小米】双旗舰 Redmi K40 系列正式发布

双旗舰 Redmi K40 系列正式发布。K40 后置配备 4800 万主摄(IMX 582)+500 万长焦微距+800 万超广角,K40 Pro 主摄升级为 6400 万主摄(IMX686),K40 Pro+后置为一亿像素(三星 HM2),另外两颗镜头参数不变,前置均为 2000 万像素自拍镜头。(集微网)

【世运电路】吸收合并全资子公司世茂电子

世运电路吸收合并全资子公司世茂电子,募投项目“鹤山世茂电子科技有限公司年产 300 万平方米线路板新建项目(一期)”的实施主体由世茂电子变更为世运电路。(中财网)

【世运电路】控股股东减持世运转债 100 万张

世运电路控股股东新豪国际集团有限公司减持世运转债 100 万张,占发行总量的 10%,此次减持完成后,仍持有世运转债 500 万张,占发行总量的 50%。(格隆汇)

【百强电子】5G 高阶线路板生产制造项目开工

百强电子 5G 高阶线路板生产制造项目开工。该项目主要建设年产 100 万平方米 HDI 高密度互联多层线路板、双面印刷线路板、多层线路板、柔性线路板、软硬结合板等生产线。项目总投资 15 亿元人民币，其中固定资产投资 10 亿元，分三期建设。(PCB 资讯)

【胜宏科技】计划投资建设多层高密度印制线路板项目

胜宏科技计划在海门投资 100 亿元，建设多层高密度印制线路板项目，打造一流的 PCB 智慧工业园区。(PCB 网城 ISPCAIGPCA)

【中兴】中兴发布第二代量产屏下摄影技术

2021MWC 上海展开幕，中兴手机第二代量产屏下摄像技术瞩目 (wind)

【苹果】苹果屏下指纹识别专利曝光

苹果屏下指纹识别专利曝光，具备深度探测器，可生成 3D 图像，不仅可以用于探测指纹、掌纹，还能进行 3D 面部扫描及视网膜扫描。(摩尔芯闻)

【苹果】据 IT 之家，苹果 iPhone 13 将使用高通骁龙 5G 基带 X60: 5 纳米工艺

据台湾《电子时报》昨天报道，苹果的下一代 iPhone 13 系列将使用高通公司的 5G 基带骁龙 X60，由三星公司负责芯片制造。(IT 之家)

【华为】发布新一代折叠旗舰 MateX2

华为发布新一代折叠旗舰 MateX2，前置采用 1600 万像素的摄像头；后置采用 5000 万主摄+1600 万超广角+1200 万长焦+800 万潜望式长焦的四摄。镜头由大立光和舜宇光学瓜分，而摄像头模组主要供应商为欧菲光、舜宇光学、丘钛科技、立景创新，指纹模组由丘钛科技供应。(摄像头观察)

【华为】发布 F5G 超级站点解决方案

上海举办的 MWC2021 大会上，华为针对全球运营商，发布 F5G 超级站点解决方案。(wind)

【三星】发布全新的 ISOCELL GN2 传感器

三星正式发布全新的 ISOCELL GN2 传感器，单位像素面积 1.4 μm ，1/1.12 英寸大底和像素，支持智能 ISO Pro 和 Dual Pixel Pro 和四合一技术，可输出高达 1 亿像素超高清照片。(中关村在线)

【三星】三星显示器目前正在开发可折叠的 OLED 面板

据韩媒 TheElec，三星显示器目前正在开发可折叠的 OLED 面板，向 OPPO、小米和谷歌供货，使用这些面板的智能手机将在年内推出。(格隆汇)

【三星】三星电子存储业务主管将被任命为韩国半导体产业协会会长

由于金乔永(Jin Gyo-young)在三星电子内部的职务发生了变化，他已提前卸任韩国半导体产业协会会长(KSIA)，三星电子存储业务的现任总裁 Lee Jung-bac，已被任命为接任者。(TechWeb)

【三星】将提供新一代高性能固态硬盘

三星半导体将为中国数据中心客户提供新一代高性能固态硬盘 -- PM9A3 U.2，支持 PCIe 4.0，使用三星第六代 3D 闪存(V-NAND)技术，基于 NVMe 协议，完全符合开放计算项目(OCP)NVMe 云端固态硬盘规范，实现了更高级别的稳态随机写入性能，同比上一代产品提升了 4 倍。(美通社)

【艾迈斯半导体】联手 ArcSoft，推出 3D dToF 传感方案

ams 联手 ArcSoft，推出 3D dToF 传感方案，实现即时定位与地图构建 (SLAM) 和 3D 图

像处理。(摩尔芯闻)

【CREE】完成 5 亿美元的市场股票发行

CREE 完成 5 亿美元的市场股票发行，以约 5 亿美元的毛收益出售了 4,222,511 股普通股。(公司官网)

【英飞凌】新的加密控制器平台为非接触式和卫生交易提供出色的灵活性和高级保护

英飞凌推出新的加密控制器平台，为非接触式和卫生交易提供出色的灵活性和高级保护。配备高性能、高能效的 32 位 ARM 安全核心 SC300 TM 双界面安全芯片。(公司官网)

【英飞凌】用于预测性维护的新型评估套件可在智能建筑中快速轻松地监控状态

英飞凌科推出新的 XENSIV 预测性维护评估套件，该套件与物联网服务提供商 Klika Tech 共同开发，并由云服务提供商 AWS 提供支持，为客户提供端到端解决方案。目标应用包括供暖，通风和空调 (HVAC) 设备以及智能建筑的电机，风扇，驱动器，压缩机，制冷和其他组件。(公司官网)

【英飞凌】加强其管理委员会

自 2021 年 4 月 15 日起，英飞凌将设立首席数字转型官 (CDTO) 管理委员会职位，监事会已任命康斯坦茨·胡芬贝彻担任这一职务，管理委员会从 4 名成员扩大到 5 名成员。在 5 月份的会议上，监事会将会把首席财务官斯文·施耐德的合同再延长 5 年。(公司官网)

【英飞凌】推出 OPTIGA™认证 IDoT 解决方案，以增强防伪设备防护能力

消费类设备，家用电器和工业机械始终面临着假冒备件和配件的风险。伪造品可能会损害功能，用户安全以及品牌价值。为了解决这个问题，英飞凌推出了 OPTIGA™认证 IDoT 解决方案，以增强防伪设备防护能力，是业界领先的嵌入式安全解决方案，提供基于 ECC 的增强硬件安全性和出色的灵活性，以满足客户和应用程序需求。(公司官网)

【意法半导体】将在 2021 年世界移动大会上海展出智能移动，电源和能源管理以及物联网和 5G 的行业领先解决方案

意法半导体 (NYSE: STM) 是为全球电子应用领域的客户提供服务的全球半导体领导者，将于 2021 年上海世界移动大会展出。意法半导体将以“我们的技术始于您”为主题，展示其针对智能移动性，电源和能源管理以及物联网和 5G 的行业领先产品和解决方案。(公司官网)

【意法半导体】通过 STM32MP1 生态系统扩展增强 AI 和 IoT 应用开发的安全性

意法半导体通过 STM32MP1 生态系统扩展增强 AI 和 IoT 应用开发的安全性，通过为 OP-TEE (开放式便携式受信任执行环境) 和 TF-A (受信任的固件-A) 项目等安全机制提供代码，ST 帮助 STM32MP1 开发人员解决其应用程序中信息安全的关键概念：机密性，完整性，可用性和真实性验证。(公司官网)

【意法半导体】推出具有先进性能和网络安全性的超低功耗 STM32U5 微控制器

意法半导体推出具有先进性能和网络安全性的超低功耗 STM32U5 微控制器，高效的 40 纳米制程技术和节能创新可将所有模式下的能耗降至最低，具有 Arm 嵌入式内核以及先进的网络安全，图形和外围设备，可满足要求苛刻的消费和工业应用程序。(公司官网)

【安森美】汽车芯片短缺问题预计在下半年解决

安森美半导体 CEO 在接受采访时预计，全球范围内的汽车芯片产能吃紧的情况最迟将在今年下半年缓解，汽车芯片是半导体终端市场最大推动力。安森美半导体预计本季度营收在 14.1 亿-15.1 亿美元之间。如果能达到短期的指导目标，第一季度营收将同比增长至少 10%。(科创板日报)

【华润微】发布业绩快报，2020 年度净利润升 139.66%至 9.6 亿元

华润微发布 2020 年度业绩快报，实现营业总收入 69.77 亿元，同比增长 21.49%；营业利润 10.68 亿元，同比增长 123.64%；利润总额 10.82 亿元，同比增长 113.94%；归属于母公司所有者的净利润 9.60 亿元，同比增长 139.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8.5 亿元，同比增长 311.98%；基本每股收益 0.8334 元。（格隆汇）

【奥维睿沃】2020 年显示器线上销量 810.4 万台，电竞显示器表现最优

据奥维睿沃统计，2020 年显示器线上销量共 810.4 万台，同比 2019 年上涨了 23%。线上销售额共 94 亿元，同比增长 12%。（半岛网）

【京东方】2020 年全球智能手机面板出货排行：京东方超越三星，跃居第一

近日，市场调研机构群智咨询发布“2020 全球智能手机面板”市场报告，2020 年全球智能手机面板出货总出货量 18.88 亿片，同比增长 6%。京东方以 4.08 亿片出货量成为全球第一面板制造商，占据 21.6%市场份额，同比增长 5.2%。（快科技）

【彩虹股份】高世代液晶基板玻璃项目一期进入试生产阶段

彩虹股份公告，公司非公开发行募集资金增资彩虹合肥液晶玻璃有限公司建设的高世代(G8.5+)液晶基板玻璃项目进展顺利。该项目一期第 2 条产线建设于 2020 年 8 月启动，2021 年 2 月 26 日成功点火，进入试生产阶段。（格隆汇）

【高通】高通将成为通用“唯一”芯片供应商

高通公司近期表示推出具有不同功能和定价的多种车用芯片，将成为通用汽车公司唯一的车用芯片供应商。通用汽车公司将使用高通的“驾驶舱”芯片，该芯片可运行自动驾驶系统，功能覆盖汽车的测速仪以及仪表盘信息娱乐系统。（财经网）

【比亚迪】比亚迪汉系列将很快搭载 HMS for Car 快应用服务

比亚迪赵长江近日在社交媒体表示，比亚迪汉系列将很快搭载 HMS for Car 快应用服务。据悉，HMS for Car 是华为智慧车载云服务解决方案，基于华为终端云服务丰富的应用生态，可根据实时网络以快应用的形式为车机提供高品质的交互体验，包含车载应用市场、华为智慧助手等功能。（财经网）

【英伟达】发布 2021 财年第四财季财报，营收创纪录、净利润同比大增超过 50%

据国外媒体报道，英伟达在当地时间周三发布了营收创纪录、净利润同比大增超过 50%的 2021 财年第四财季财报，而从给出的业绩预期来看，下一财季的营收有望再创新高。（TechWeb）

【晶晨股份】披露 2020 年度业绩快报，归属于母公司所有者的净利润 1.16 亿元

晶晨股份(688099.SH)披露 2020 年度业绩快报，公司实现营业总收入 27.38 亿元，同比增长 16.14%；归属于母公司所有者的净利润 1.16 亿元，同比下降 26.58%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8429.44 万元，同比下降 40%；基本每股收益为 0.28 元。（公司公告）

【晶晨股份】发布关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

晶晨股份发布公告称，晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会于近日收到财务总监周长鸣先生递交的书面辞职报告，周长鸣先生因个人原因申请辞去财务总监职务，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，周长鸣先生的辞职报告自送达公司董事会之日生效。周长鸣先生辞去公司财务总监职务后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，周长鸣先生通过上海晶兮商务咨询中心间接持有公司 0.02%的股份。（每日经济新闻）

【瑞芯微】拟于关联方共同投资上海合见以发展工业软件

瑞芯微(603893.SH)公告，公司全资子公司上海翰迈电子科技有限公司拟与公司控股股东励

民先生、上海虞齐企业管理合伙企业(有限合伙)等共同投资上海合见工业软件集团有限公司,其中上海翰迈以货币出资3,000万元,认缴标的公司注册资本3,000万元;励民先生以货币出资2,000万元,认缴标的公司注册资本2,000万元;上海虞齐以货币出资6亿元,认缴标的公司注册资本6亿元。本次交易完成后,上海翰迈、励民先生和上海虞齐分别持有标的公司2.247%、1.498%和44.945%的股权。(智通财经)

【荣耀】 将采购5500万套4G手机芯片

据中电网,荣耀将采购4500万-5500万颗紫光展锐的智能手机SoC芯片。不过,据透露,荣耀向紫光展锐采购的这批芯片并不是5G芯片,而是以4G芯片套片为主。(中电网)

【信维通信】 公司与小米有合作

信维通信在互动平台表示,公司与小米有合作,目前业务规模较小。(金十数据)

【ADI】 ADI公司的电池管理系统IC和汽车音频总线助力沃尔沃全电动XC40 SUV

ADI和沃尔沃汽车公司宣布,沃尔沃汽车公司的首款纯电动SUV--沃尔沃XC40 Recharge--将采用ADI的集成电路(IC)提供电池管理系统(BMS)和汽车音频总线(A2BR)功能。(美通社)

【德州仪器】 任命姜寒担任德州仪器公司副总裁兼中国区总裁

德州仪器今天宣布任命姜寒担任德州仪器公司副总裁兼中国区总裁。他将领导德州仪器中国销售和市场应用团队,并负责中国区的整体运营。(美通社)

【德州仪器】 推出高度集成零级电机驱动器

据外媒报道,德州仪器公司(Texas Instruments)推出高度集成零级电机驱动器,可用于无刷直流(BLDC)电机,将电机系统的尺寸缩小高达30%。同时,提供业界最高的栅极驱动电流,作为改善保护和提高输出功率的先决条件。(盖世汽车)

【恩瑞浦】 发布对外投资暨关联交易公告

恩瑞浦发布对外投资暨关联交易公告,拟与关联方义乌华芯远景创业投资中心(有限合伙)、无限启航创业投资(天津)合伙企业(有限合伙)共同向北京士模微电子有限责任公司增资。其中,公司以自有资金投资750万元,占本次增资后标的公司注册资本的5%。(公司公告)

【恩瑞浦】 公布2020年年报业绩快报,净利润为1.85亿元

恩瑞浦公布2020年年报业绩快报,营业总收入5.66亿元,同比去年86.61%,净利润为1.85亿元,同比去年160.11%,基本EPS为2.84元,加权平均ROE为21.46%。(公司公告)

【芯朋微】 公布2020年年报业绩快报,净利润为9973.62万元

芯朋微公布2020年年报业绩快报,营业总收入4.29亿元,同比去年28.11%,净利润为9973.62万元,同比去年50.73%,基本EPS为1.04元,加权平均ROE为12.19%。(公司公告)

【芯海科技】 公布2020年年度业绩快报,净利润为8911.34万元

芯海科技公布2020年年度业绩快报,营业总收入3.63亿元,同比去年40.40%,净利润为8911.34万元,同比去年108.20%,基本EPS为1.10元,加权平均ROE为20.29%。(公司公告)

【海力士】 SK海力士与ASWL签订EUV设备五年采购合同

SK海力士与ASML公司签订了一个超级大单,未来5年内将斥资4.8万亿韩元,约合43.4亿美元购买EUV光刻机。SK海力士在一份监管文件中称,这笔交易是为了实现下一代工艺芯片量产的目标,扣除配套的服务费用,总数量可能在30-35台左右。(快科技)

【中芯国际】 公司注册资本增加2.5亿美元

中芯国际(上海)公司注册资本增加2.5亿美元。企查查2月23日信息显示,中芯国际集

成电路制造(上海)有限公司发生工商变更,注册资本从“219000 万美元”增加到“244000 万美元”,增资达 2.5 亿美元。(集微网)

【芯启源】完成数亿元新一轮融资

芯启源完成数亿元新一轮融资,为打造 DPU 生态、布局高端 EDA 市场。近日芯启源电子科技有限公司(以下简称“芯启源”)宣布完成数亿元 Pre A2 轮融资,由和利资本领投。(集微网)

【上海复旦】预期 2020 年度取得归属于母公司所有者盈利约人民币 1.25 亿元

上海复旦(01385)发布公告,预期集团于 2020 年度将转亏为盈并取得归属于母公司所有者盈利约人民币 1.25 亿元,而 2019 同期则取得经审核归属于母公司所有者约人民币 1.62 亿元的亏损。(公司公告)

【台积电】传台积电扩大投资化合物半导体,购 16 台氮化镓相关设备

台媒报道,在半导体界传出台积电扩大投资化合物半导体。据称,台积电购买氮化镓(GaN)相关设备达 16 台,比既有的六寸厂内的 6 台增加 2 倍多,这相当于产能将增达逾万片左右,显示客户端下单需求扩大。(GaN 世界)

【利扬芯】披露 2020 年度业绩快报,归属母公司所有者的净利润 5087.18 万元

利扬芯(688135.SH)披露 2020 年度业绩快报,实现营业总收入 2.52 亿元,同比增长 8.47%;归属母公司所有者的净利润 5087.18 万元,同比下降 16.38%;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 4467.77 万元,同比下降 23.77%;基本每股收益 0.48 元。(公司官网)

【圣邦股份】圣邦股份(300661.SZ)两股东解除质押 225 万股

智通财经讯,圣邦股份(300661.SZ)发布公告,公司近日分别接到持股 5%以上股东鸿达永泰、宝利鸿雅的告知函,获悉鸿达永泰、宝利鸿雅分别将其持有公司的部分股份解除质押。本次上述股东合计解除质押股份 225 万股,占公司总股本比例 1.44%。(智通财经)

风险提示:

- 1) 政策落实对半导体产业的推动效果尚不明确;
- 2) 宏观经济下行,面板下游需求不及预期。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起6个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来6个月的投资收益率领先沪深300指数5%以上；
- 中性—未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6个月的投资收益率落后沪深300指数5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数15%以上；
- 增持—未来6-12个月的投资收益率领先市场基准指数5%至15%；
- 中性—未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至5%；
- 减持—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数5%至15%；
- 卖出—未来6-12个月的投资收益率落后市场基准指数15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深300指数。